



SYSTEM DOCIEPLEŃ Z KLINKIEREM INFATEC®

- łatwy i szybki w montażu
- trwała i estetyczna elewacja
- wysokie oszczędności energetyczne
- komfort użytkowania

Wyrób objęty aprobatą techniczną AT 15-7150/2006

INNOWACYJNY, ORYGINALNY SYSTEM DOCIEPLEŃ Z KLINKIEREM INFATEC®

I. PODŁOŻE

1. Podłoże do którego przyklejane są płyty INFATEC® P powinno być stabilne, nośne, suche i czyste – pozbawione elementów zmniejszających przyczepność kleju takich jak kurz, pył, olej szalunkowy, łuszczące się warstwy farby, pylący stary tynk itp.
2. Poniższa tabela przedstawia niektóre sposoby przygotowania podłoża.

| Rodzaj defektu podłoża | Czynność przygotowawcza |
|---|--|
| Kurz, pył | Oczyścić za pomocą szczotki, sprężonego powietrza lub wodą pod ciśnieniem. |
| Luźne resztki lub nadmiar zapraw w spoinach | Skuć i oczyścić. |
| Nierówności, ubytki | Skuć, wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z zastosowaniem zaleceń producentów zapraw. |
| Brud, sadza, tłuszcz | Zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem środków czyszczących, spłukać czystą wodą. |
| Mleczko cementowe na elementach betonowych | Zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem. |
| Środki antyadhezyjne | Zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem środków czyszczących, spłukać czystą wodą. |
| Łuszczące farby | Usunąć mechanicznie za pomocą środków chemicznych lub wodą pod ciśnieniem. |
| Nadmiernie nasiąkliwe podłoże (pyłące, osypujące się) | Zastosować odpowiedni preparat gruntujący, np. INFATEC® T, zgodnie z instrukcją producenta. |

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić próbę. W kilku miejscach podłoża przykleić próbki płyty INFATEC® P o wymiarach ok. 10 x 10 [cm]. Po ok. 3 dniach przeprowadzić próbę odrywania. Przyjmuje się, że podłoże jest odpowiednio przygotowane, jeżeli podczas ręcznego odrywania nastąpi rozwarstwienie płyty (część płyty pozostanie przyklejona do podłoża).

3. Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyień powierzchni i krawędzi. Nie dopuszczalne jest wyrównywanie podłoża za pomocą grubszej warstwy zaprawy klejowej albo podkładania materiału izolacyjnego.

Poniższa tabela podaje normatywne odchylenia dla przykładowych rodzajów podłoża.

| Odchyłka | Z cegły i pustaków ceramicznych, mury spoinowane | Z betonu komórkowego |
|--|--|----------------------|
| Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów na długości 1 [m] | 3 [mm] | 4 [mm] |
| Odchylenia od pionu powierzchni krawędzi na całej wysokości ściany | 20 [mm] | 15 [mm] |
| Odchylenia powierzchni muru od zaprojektowanego kąta | 3 [mm] | 10 [mm] |

II. MOCOWANIE LISTWY STARTOWEJ INFATEC® L

1. Szerokość listwy startowej odpowiada grubości płyty montażowej INFATEC® P, powiększonej o 20 [mm] (miejsce na kształtkę klinkierową)
2. W narożu listwę startową należy przyciąć pod kątem 45° i połączyć z podobnie przyciętą listwą ściany sąsiedniej.
3. Poszczególne listwy należy łączyć ze sobą za pomocą łączników, aby zachować jednakowy poziom. (zalecamy łączniki Koelner LPC)

III. PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEJĄCEJ INFATEC® K

Zaprawę klejącą INFATEC® K przygotowuje się zgodnie z kartą katalogową produktu. Należy zwracać uwagę na:

- a) ilość wody zarobowej, która nie powinna przekraczać podanej w instrukcji (w proporcji 8,25 ÷ 8,75[l] na 25 [kg] suchej mieszanki),
- b) ponowne przemieszanie zaprawy po ok 5 minutach od pierwszego mieszania (jest to tzw. czas dojrzewania zaprawy),
- c) wykorzystanie przygotowanej zaprawy w ciągu 4 godzin (czas gotowości zaprawy do pracy). Niedopuszczalne jest dolewanie wody do zaprawy i wykorzystywanie jej po czasie gotowości do pracy.

IV. PRZYGOTOWANIE PŁYT MONTAŻOWYCH INFATEC® P

1. Przed montażem należy przygotować odpowiednią ilość połówek płyt montażowych INFATEC® P, tak aby można było wykonać elewację zgodnie z zasadą „wiązania” płyt (mijkankowe obłożenie, z przesunięciem o ok. ½ długości płyty).
2. Płyty montowane w narożniku należy przyciąć pod kątem 45°
3. Przy montowaniu pierwszej warstwy płyt montażowych INFATEC® P należy odciąć pierwszą prowadnicę poziomą na wysokości jej górnej krawędzi.
4. Do cięcia płyt zaleca się stosować urządzenia elektrooporowe, które dają równą i gładką powierzchnię cięcia.

V. KLEJENIE PŁYT INFATEC® P

1. Zaprawę klejową na płytę nakłada się metodą obwodowo-punktową. Po obwodzie płyty nakładamy pasmo kleju o szerokości min 3 [cm], oraz w środku płyty nakładamy 3 do 6 placków kleju. Po dociśnięciu płyty do podłoża minimum 60% powierzchni płyty powinno być pokryte zaprawą klejową.
2. Przy równych i gładkich podłożach dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty, tak by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 4-10 [mm].
3. Zaprawę klejącą nakłada się tylko na płyty INFATEC® P, nigdy na podłoża!

4. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej należy przyłożyć płytę INFATEC® P do podłoża i docisnąć równomierne np. za pomocą drewnianej pacy o dużej powierzchni. Nie wolno używać młotków, które mogą prowadzić do uszkodzenia płyty.
5. Prawidłowy kierunek montażu wyznacza logo „INFATEC®” na płycie, które powinno się znajdować zawsze w lewym górnym rogu płyty. Takie ułożenie zapewnia prawidłowe ustawienie wpustu płyty INFATEC® P. Dzięki temu nie ma możliwości przedostawania się wody pomiędzy płyty montażowe.
6. Brzeg płyty musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania można sprawdzić po związaniu kleju przez ucisk naroży – nie powinno następować ich ugięcie.
7. Zaprawa klejowa nie może się przedostawać na boczne krawędzie płyty. Jej nadmiar należy usunąć. Płyty powinny być dokładnie dociśnięte do siebie. Pozostawienie zaprawy w spoinach powoduje powstawanie mostków termicznych.

VI. MOCOWANIE ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH INFATEC® D

1. Łączniki mechaniczne INFATEC® D z trzpieniem stalowym montuje się po minimum 2 dniach od przyklejenia płyt, po związaniu zaprawy klejowej.
2. Łączniki w ilości do 9 szt./m² osadza się wykorzystując zagłębienia w płycie montażowej.
3. Do wiercenia otworów w betonie należy stosować wiertarki udarowe. Do wiercenia otworów w materiałach porowatych (cegła dziurawka, pustak szczelinowy, beton komórkowy) nie wolno stosować udaru! W przeciwnym wypadku zostanie zniszczona struktura materiału i łącznik nie będzie zakotwiony wystarczająco mocno.
4. Nie wolno zastępować łączników INFATEC® D innymi łącznikami np. z trzpieniem tworzywowym i mniejszej nośności!
5. Wymagana długość łącznika w zależności od grubości płyty izolacyjnej INFATEC® P:

| Grubość płyty INFATEC® P [mm] | Niezbędna długość łącznika INFATEC® D [mm] |
|-------------------------------|--|
| 80 | 130 |
| 100 | 150 |
| 120 | 170 |
| 140 | 190 |

VII. KLEJENIE KSZTAŁTEK KLINKIEROWYCH INFATEC® C

1. Kształtki klinkierowe klei się również za pomocą zaprawy klejącej INFATEC® K.
2. Zaprawę klejową INFATEC® K nanosi się na płytę montażową INFATEC® P pomiędzy prowadnicami poziomymi (tzw. rozwinięta powierzchnia klejenia) za pomocą pacy zębatej (zęby 6-8 [mm]).
3. Na kształtkę klinkierową również nanosi się ciekłą warstwę zaprawy.
4. Kształtkę umieszczamy pomiędzy prowadnicami, dociskając oraz poruszając ruchem poprzecznym, tak aby klej wypełnił dokładnie przestrzeń pod kształtką.
5. Dopuszczalne jest nakładanie zaprawy klejowej na samą kształtkę klinkierową, następnie kształtkę dociska się do powierzchni klejenia, tak aby klej wypełnił przestrzeń pod kształtką.
6. Pomiędzy kolejnymi kształtkami należy zachować odstęp ok 15 [mm] (szerokość spoiny). Należy na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej.
7. Zaprawa klejąca zachowuje swoje właściwości przez ok 30 minut po nałożeniu na płytę. Dlatego nie należy nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię.
8. Klejenie kształtek zaleca się zaczynać od kształtek narożnikowych.

VIII. SPOINOWANIE

1. Do spoinowania (fugowania) wykorzystuje się gotową masę fugową INFATEC® F.
2. Zaprawę fugową INFATEC® F przygotowuje się zgodnie z kartą katalogową produktu.
3. Konsystencja zaprawy powinna być półsucha. Dlatego nie należy przekraczać podanej w instrukcji ilości wody zarobowej (2,25 ÷ 3,5 [l] na 25 [kg] suchej zaprawy).
4. Krawędzie boczne przyklejonych kształtek nie mogą być zabrudzone zaprawą klejową INFATEC® K.
5. Masę fugową nakłada się za pomocą kielni do spoin tzw. „fugówki” zaczynając od góry elewacji.

6. Masa fugowa musi wypełniać spoiny całkowicie (licować się z powierzchnią kształtki) tzw. fugowanie na „pełne spoiny”. Zastosowanie cieńszych spoin nie gwarantuje utrzymania jakości systemu INFATEC®.
7. Nadmiar masy fugowej usunąć z kształtek za pomocą szczotki lub pędzla ławkowca.

IX. RYSUNKI

Z pomocnymi podczas projektowania i montażu rysunkami można zapoznać się i pobrać na stronie internetowej www.infatec.pl

X. UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Tylko dokładne stosowanie się do wytycznych montażu systemu INFATEC® zapewnia trwałość systemu oraz bezpieczeństwo użytkownika.

Ciężar 1 m² elewacji w systemie INFATEC® przy grubości płyty INFATEC® P 10 [cm] to około 45 [kg].

| Material | Przybliżony ciężar [kg/m ²] |
|----------------------------------|---|
| INFATEC® K – klejenie płyty | 4 |
| Płyta termoizolacyjna INFATEC® P | 3 |
| INFATEC® K – klejenie kształtek | 4 |
| Kształtka klinkierowa INFATEC® C | 28 |
| INFATEC® F – spoina 10 [mm] | 6 |
| Razem: | 45 |

Awaria systemu INFATEC® spowodowana nieprawidłowym montażem może spowodować w skrajnym wypadku (źle przygotowane, nienośne podłoże oraz wadliwie osadzone łączniki) odpadnięcie elewacji od podłoża. Ciężar 45 [kg] może wyrządzić poważne szkody materialne, oraz zagrozić życiu i zdrowiu osób przypadkiem przechodzących.

Producentem systemu INFATEC® jest:

Jacob Sp. z o.o.

Ul. Ks. bpa Bogedaina 2

40-749 Katowice

tel : 0-32/205-51-13

fax: 0-32/205-51-14

www.infatec.pl

infatec@infatec.pl

Pytania techniczne dotyczące systemu należy kierować na adres: infatec@infatec.pl

